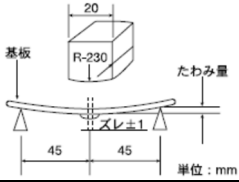
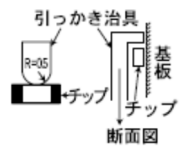


一般民生用 セラミック RF デバイス

■信頼性

1. 使用温度範囲	
規格値	-40～+85℃
2. 保存温度範囲	
規格値	-40～+85℃
試験方法・摘要	※テーピングされた状態では、-20～+40℃
3. 耐基板曲げ性	
規格値	外観：機械的損傷のないこと。
試験方法・摘要	たわみ量：2mm 試験基板：ガラス基材エポキシ樹脂基板 基板厚み：0.8mm 
4. 端子電極固着力	
規格値	特性：電気的特性を満足すること。 外観：著しい異常が無いこと。
試験方法・摘要	加圧荷重：5N 加圧時間：10秒 
5. はんだ付け性	
規格値	端子部分の浸漬した表面において、75%以上が新しいはんだで覆われていること。
試験方法・摘要	はんだ温度：240±5℃ 浸漬時間：3±1秒 前処理：フラックスに浸漬する。 浸漬及び引上げ速度：25mm/s
6. はんだ耐熱性	
規格値	特性：電気的特性を満足すること。 外観：著しい異常が無いこと。
試験方法・摘要	予熱：150℃ 2分間 はんだ温度：260±5℃ 浸漬時間：5±0.5秒 前処理：フラックスに浸漬する。 浸漬及び引上げ速度：25mm/s 後処理：試験後、標準状態に、2～3時間放置する。

▶ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、当社製品をご検討頂く際には、納入仕様書にて詳細な仕様の確認をお願いします。また、各商品の詳細情報(特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など)につきましては、当社 Web サイト(<http://www.ty-top.com/>)に掲載しております。

7. 温度サイクル

規格値	特性：電気的特性を満足すること。 外観：著しい異常が無いこと。															
試験方法・摘要	JIS C60068-2-14 によります。 1 サイクルの条件 <table border="1"><thead><tr><th>段階</th><th>温度(°C)</th><th>時間(min)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>-40±3</td><td>30±3</td></tr><tr><td>2</td><td>常温</td><td>3 以下</td></tr><tr><td>3</td><td>85±2</td><td>30±3</td></tr><tr><td>4</td><td>常温</td><td>3 以下</td></tr></tbody></table> 試験回数：100 サイクル 製品保持：試験用基板にはんだ付け。 後処理：試験後、標準状態に、2～3 時間放置する。	段階	温度(°C)	時間(min)	1	-40±3	30±3	2	常温	3 以下	3	85±2	30±3	4	常温	3 以下
段階	温度(°C)	時間(min)														
1	-40±3	30±3														
2	常温	3 以下														
3	85±2	30±3														
4	常温	3 以下														

8. 耐湿性

規格値	特性：電気的特性を満足すること。 外観：著しい異常が無いこと。
試験方法・摘要	温度：+85±2°C 湿度：85±5%RH 試験時間：1000 時間 後処理：試験後、標準状態に、2～3 時間放置する。

9. 高温放置

規格値	特性：電気的特性を満足すること。 外観：著しい異常が無いこと。
試験方法・摘要	温度：+85±2°C 試験時間：1000 時間 後処理：試験後、標準状態に、2～3 時間放置する。

10. 低温放置

規格値	特性：電気的特性を満足すること。 外観：著しい異常が無いこと。
試験方法・摘要	温度：-40±2°C 試験時間：1000 時間 後処理：試験後、標準状態に、2～3 時間放置する。

標準状態：標準状態とは、下記の状態をいいます。

温度 5～35°C、相対湿度 45～85%、気圧 86～106kPa

但し、判定に疑義を生じた場合は、20±2°C、相対湿度 65～70%、気圧 86～106kPa で行います。

特に指定のない限り全ての試験は標準状態で行います。